



## News Release

### **Amkor、アンテナ・イン・パッケージ技術を 5G ミリ波スマートフォン、IoT、および新たなアプリケーションに展開**

テンピ、アリゾナ、2019 年 7 月 22 日 — 半導体のパッケージングおよびテストのリーディングプロバイダーである Amkor Technology, Inc. (Nasdaq : AMKR) は、5G ミリ波アンテナ・イン・パッケージ (AiP) テクノロジーの道を切り開いています。Amkor の最先端の AiP 技術は、スマートフォンやその他のモバイル機器向けに設計されたモジュールにすでに採用されています。2018 年 7 月、Amkor は OSAT として最初に 5G ミリ波 AiP 技術を市場に投入し、幾年にもわたる高度なシステムインパッケージ (SiP) に関する実績を更に拡大しました。

「当社は、世界的な大手通信会社と共に、我々の AiP 技術を 5G 製品アプリケーションに展開し、彼らと協力して最初の AiP 製品を市場に投入しました」。Amkor Technology 社のコーポレートバイスプレジデントを務める Ron Huemoeller はそう述べています。また彼は「私たちにとって重要な点は、高度に集積された電子回路の実装に不可欠な革新的なパッケージングの概念で AiP 製品を開発し続けることです」と付け加えました。

業界のコンサルティング会社である Yole Développement 社によると、RF フロントエンドモジュールの SiP 市場全体は 2023 年までに 53 億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率 (CAGR) は 11.3% です。

「5G は OSAT プロバイダーに多くのパッケージングビジネスをもたらすでしょう」。Yole Korea のパッケージング、アセンブリ、サブストレート部門主席アナリスト兼ディレクターの Santosh Kumar は、そう述べています。「スマートフォンの一般的な RF フロントエンドコンポーネントには、さまざまなスイッチ、フィルタ、アンプ、およびアンテナが含まれています。今後 SiP 技術は更に多くのバンドに対応し、ますます小さな面積で回路の開発を行う必要があります」。

SiP の大規模量産能力と AiP 技術に加えて、Amkor は、両面アセンブリ、チップ埋め込み基板、高度な RDL 成形や様々なタイプの RF シールドなど、回路密度を最大化し 5G アプリケーションの製造に必要とされる高度なパッケージングフォーマットに対応する幅広いツールセットを開発しました。このツールセットは、当社の RF およびアンテナパッケージ設計に関する知見と相まって、5G ネットワーク向けの高度なパッケージアセンブリおよびテストテクノロジーと複数の IC の組み合わせに伴い発生する課題をアウトソーシングし、また同時に投資の抑制を考えるお客様に、当社ならではのソリューションを提供いたします。

5G をサポートするパッケージの需要が高まっている中、Amkor はすでに AiP テクノロジーの実装を開始し量産に移行しています。SiP と AiP に関する Amkor ソリューションの詳細については、<https://amkor.com/aip-aop/> をご参照ください。

#### **About Amkor Technology, Inc.**

Amkor Technology, Inc. は、半導体のパッケージングとテストを提供する世界有数の企業です。1968 年の設立以来、半導体パッケージングおよびテスト受託のパイオニアであり続け、今日では世界中の 250 を越える半導体企業、ファングリ、OEM の戦略的パートナーとなりました。Amkor のグローバルネットワークは、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界の主要なエレクトロニクス機器製造地域に配置された、トータル 100 万平方メートルにおよぶ製造拠点、開発センター、営業およびサポートオフィスにより構成されています。詳細情報は [www.amkor.com](http://www.amkor.com) をご覧ください。



## News Release

# # #

### **Keywords**

OSAT

Semiconductor packaging

Advanced IC packaging

Assembly and test

Antenna-in-package

System-in-package

SiP

AiP

5G mmWave

RDL molding

RF shielding

IoT

Smartphone

### **Contacts**

Investor Relations

Vincent Keenan

Vice President, Investor Relations

480-786-7594

Media Relations

Debi Polo

Senior Manager, Marketing Communications

480-786-7653

**Social Media:** @amkortechology